



平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年1月30日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

上場取引所 東

コード番号 8035

URL <http://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役会長兼社長

(氏名) 東 哲郎

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 執行役員

(氏名) 原田 芳輝

TEL 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 平成26年2月7日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期第3四半期	392,900	9.6	7,244	35.8	9,091	3.3	△35,621	—
25年3月期第3四半期	358,511	△21.3	5,336	△87.6	8,805	△81.2	△936	—

(注) 包括利益 26年3月期第3四半期 △25,936百万円 (—%) 25年3月期第3四半期 3,099百万円 (△85.6%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年3月期第3四半期	△198.79	—
25年3月期第3四半期	△5.23	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
26年3月期第3四半期	801,290	568,279	69.4
25年3月期	775,527	605,127	76.5

(参考) 自己資本 26年3月期第3四半期 556,120百万円 25年3月期 593,032百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年3月期	—	25.00	—	26.00	51.00
26年3月期	—	25.00	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	25.00	50.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

平成25年3月期の第2四半期末配当金の内訳は、普通配当15円、記念配当10円です。

平成25年3月期の期末配当金の内訳は、普通配当16円、記念配当10円です。

3. 平成26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	605,000	21.7	30,000	139.1	33,000	97.6	△22,000	—	△122.77

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

26年3月期3Q	180,610,911 株	25年3月期	180,610,911 株
26年3月期3Q	1,413,144 株	25年3月期	1,424,203 株
26年3月期3Q	179,190,171 株	25年3月期3Q	179,175,008 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】5ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、平成26年1月30日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料につきましては、開催と同時に当社ホームページに掲載する予定です。

【添付資料】

[目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	4
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	5
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	6
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	6
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	6
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	6
3. 四半期連結財務諸表	7
(1) 四半期連結貸借対照表	7
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	8
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(四半期連結損益計算書関係)	10
(セグメント情報等)	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間においては、欧米の財政問題の影響など先行きに若干の不透明さはあるものの、日本を含め世界経済は、総じて緩やかに回復しつつあります。

当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業においては、モバイル端末全般の需要は引き続き堅調に推移しております。また、クラウドサービスの普及やビッグデータの活用を背景としたデータセンター向けメモリー需要が伸長しております。

このような状況のもと、当第3四半期連結累計期間の連結業績は、売上高3,929億円(前年同期比9.6%増)、営業利益72億4千4百万円(前年同期比35.8%増)、経常利益90億9千1百万円(前年同期比3.3%増)、また、P V製造装置事業及びTEL NEXX, Inc.の事業計画を見直したことによる、のれん等に関する減損損失、並びに拠点再編計画に基づく固定資産の減損等465億8千3百万円を計上したことにより四半期純損失は356億2千1百万円(前年同期は9億3千6百万円の四半期純損失)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

なお、第1四半期連結会計期間から、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」に基づき報告セグメントを変更しており、以下の前年同期比較については、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

① 半導体製造装置

DRAMはモバイル機器向けの需要が依然として堅調であり、NANDフラッシュメモリーも高性能品の需要が伸びております。このような状況のもと、従来からのロジック系半導体向け設備投資に加え、メモリーメーカーにおける増産を主な目的とした投資の再開の動きも始まっており、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、2,970億5千7百万円(前年同期比5.1%増)となりました。

② FPD (フラットパネルディスプレイ) 製造装置

中国を中心に液晶パネルメーカーの設備投資が続いており、当社FPD製造装置の売上は堅調に推移しております。このような状況のもと、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、182億6百万円(前年同期比31.5%増)となりました。

③ P V (太陽光パネル) 製造装置

当社が参画している薄膜シリコン太陽光パネルの市場環境は依然厳しく、当社PV製造装置の新規受注はありませんでした。このような状況のもと、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、44億8千5百万円(前年同期は6千5百万円の売上高)となりました。なお、当セグメントの事業計画及び同事業が生み出す将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれん及び固定資産の減損損失326億3千5百万円を計上しております。

④ 電子部品・情報通信機器

電子部品事業においては、産業機器関連の事業環境が好転していることなどから、汎用ICを中心に総じて順調に推移し、情報通信機器関連事業においては、大手既存顧客を中心にストレージ機器及びネットワーク機器が底堅く推移しました。このような状況のもと、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、728億1千6百万円(前年同期比18.3%増)となりました。

⑤ その他

当セグメントの当第3四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、3億3千4百万円(前年同期比9.8%増)となりました。

(ご参考)

【連結業績】

(単位：百万円)

	当期			
	第1Q	第2Q	第3Q	第3Q累計
売上高	103,452	151,048	138,400	392,900
半導体製造装置	74,944	119,828	102,284	297,057
日本	11,648	21,585	21,589	54,823
米国	15,101	29,715	24,474	69,291
欧州	5,666	7,909	3,815	17,391
韓国	11,184	17,679	14,660	43,525
台湾	24,509	31,550	21,504	77,563
中国	4,711	4,924	12,764	22,400
東南アジア他	2,123	6,463	3,474	12,061
F P D製造装置	4,906	4,486	8,813	18,206
P V製造装置	2,062	1,225	1,196	4,485
電子部品・情報通信機器	21,426	25,359	26,029	72,816
その他	111	146	76	334
営業利益(△損失)	△9,646	7,824	9,067	7,244
経常利益(△損失)	△9,898	10,487	8,502	9,091
四半期純利益(△損失)	△2,976	5,452	△38,098	△35,621

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

【生産及び受注の実績】

1. 生産実績

(単位：百万円)

	当期			
	第1Q	第2Q	第3Q	第3Q累計
半導体製造装置	79,358	105,784	145,944	331,087
F P D製造装置	6,037	4,777	9,508	20,323
P V製造装置	2,146	1,212	1,226	4,585
合 計	87,542	111,774	156,679	355,996

(注) 1. 金額は販売価格によっております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 受注実績(受注高)

(単位：百万円)

	当期			
	第1Q	第2Q	第3Q	第3Q累計
半導体製造装置	97,708	151,322	143,495	392,526
F P D製造装置	14,491	6,351	3,885	24,729
P V製造装置	1,185	1,101	1,447	3,733
電子部品・情報通信機器	23,872	24,735	26,525	75,133
その他	111	146	76	334
合 計	137,369	183,657	175,431	496,458

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績 (受注残高)

(単位: 百万円)

	当期		
	第1Q末	第2Q末	第3Q末
半導体製造装置	164,587	196,081	237,292
F P D製造装置	25,584	27,449	22,522
P V製造装置	7,618	7,494	7,744
電子部品・情報通信機器	17,231	16,606	17,102
その他	—	—	—
合計	215,022	247,632	284,663

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 財政状態に関する説明

① 財政状態

当第3四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ708億6千6百万円増加し、5,923億6千7百万円となりました。主な内容は、受取手形及び売掛金の増加383億7千6百万円、たな卸資産の増加570億円、有価証券に含まれる短期投資の減少414億9千3百万円によるものであります。

有形固定資産は、拠点再編計画に基づく固定資産の減損等により、前連結会計年度末から201億4千3百万円減少し、1,155億5千4百万円となりました。

無形固定資産は、P V製造装置事業及びTEL NEXX, Inc. の事業計画を見直したことによるのれん等の減損等により、前連結会計年度末から288億1千4百万円減少し、311億3百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から38億5千4百万円増加し、622億6千5百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から257億6千2百万円増加し、8,012億9千万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ571億5千4百万円増加し、1,638億2千4百万円となりました。主として、支払手形及び買掛金の増加152億2千2百万円、前受金の増加289億7千2百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ54億5千5百万円増加し、691億8千6百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ368億4千7百万円減少し、5,682億7千9百万円となりました。主として、四半期純損失356億2千1百万円を計上したことによる減少、前期の期末配当46億5千8百万円及び当期の中間配当44億7千9百万円の実施による減少、連結子会社の決算期変更等による利益剰余金の減少31億9千万円、円安の影響による為替換算調整勘定の増加101億3千6百万円によるものであります。この結果、自己資本比率は69.4%となりました。

② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ21億8千8百万円減少し、831億2千5百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資1,293億7千9百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ276億2千4百万円減少し、2,125億4百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ837億4千3百万円減少の121億1千万円の支出となりました。主な要因につきましては、減損損失465億8千3百万円、前受金の増加262億8千9百万円、減価償却費186億4千3百万円、仕入債務の増加125億4百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、税金等調整前四半期純損失375億4千2百万円、たな卸資産の増加533億7千1百万円、売上債権の増加347億6千4百万円がキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として定期預金及び短期投資の減少による収入254億3千5百万円、有形固定資産の取得による支出69億6千9百万円により、前年同期の1,504億1千5百万円の支出に対し167億7千6百万円の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に短期借入の増加による収入79億3千3百万円、長期借入の増加による収入20億円、配当金の支払91億3千8百万円により、前年同期の113億8千2百万円の支出に対し2億5千1百万円の収入となりました。

【連結キャッシュ・フロー(要約)】

(単位：百万円)

	前第3四半期 連結累計期間	当第3四半期 連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	71,632	△12,110
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前 四半期純損失(△)	9,349	△37,542
減価償却費	18,426	18,643
減損損失	6	46,583
売上債権の増減額(△は増加)	75,982	△34,764
たな卸資産の増減額(△は増加)	6,857	△53,371
仕入債務の増減額(△は減少)	△20,271	12,504
その他	△18,720	35,836
投資活動によるキャッシュ・フロー	△150,415	16,776
定期預金及び短期投資の増減額(△は増加)	△80,000	25,435
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等 による支出	△55,068	-
その他(固定資産の取得等)	△15,346	△8,659
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,382	251
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,268	△5,899
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△93,433	△982
現金及び現金同等物の期首残高	158,776	85,313
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等 物の増減額(△は減少)	-	△1,206
現金及び現金同等物の四半期末残高	65,342	83,125
現金及び現金同等物並びに満期日又は償還日ま での期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資の四 半期末残高	234,191	212,504

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年3月期の連結業績につきましては、平成25年12月18日に公表しました「連結通期業績予想の修正および特別損失の計上に関するお知らせ」において、通期の連結業績予想を以下のとおり修正いたしました。

平成26年3月期の連結業績予想

	通期予想
売上高	6,050億円 (前年同期比 21.7%増)
半導体製造装置	4,750億円 (前年同期比 21.2%増)
F P D製造装置	260億円 (前年同期比 29.5%増)
P V製造装置	70億円
電子部品・情報通信機器	965億円 (前年同期比 14.0%増)
その他	5億円 (前年同期比 11.6%増)
営業利益	300億円 (前年同期比139.1%増)
経常利益	330億円 (前年同期比 97.6%増)
当期純利益(△損失)	△220億円

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社グループが合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(連結子会社の事業年度等に関する事項の変更)

従来、連結子会社のうち決算日が12月31日であった一部の在外子会社については、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っていましたが、連結財務情報のより適正な開示を図るため、第1四半期連結会計期間より、決算日を3月31日に変更又は連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用する方法に変更しております。

なお、平成25年1月1日から平成25年3月31日までの損益については、利益剰余金の増減として調整しております。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	49,632	63,500
受取手形及び売掛金	100,500	138,877
有価証券	190,497	149,004
商品及び製品	87,397	130,688
仕掛品	33,402	46,148
原材料及び貯蔵品	14,898	15,861
その他	46,351	48,843
貸倒引当金	△1,179	△557
流動資産合計	521,501	592,367
固定資産		
有形固定資産	135,697	115,554
無形固定資産		
のれん	38,372	9,923
その他	21,545	21,180
無形固定資産合計	59,918	31,103
投資その他の資産		
その他	60,522	64,228
貸倒引当金	△2,112	△1,963
投資その他の資産合計	58,410	62,265
固定資産合計	254,026	208,923
資産合計	775,527	801,290
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	36,261	51,483
短期借入金	3,756	11,994
製品保証引当金	8,344	9,369
その他の引当金	6,908	3,592
その他	51,399	87,385
流動負債合計	106,670	163,824
固定負債		
退職給付引当金	56,643	59,184
その他の引当金	580	580
その他	6,505	9,421
固定負債合計	63,730	69,186
負債合計	170,400	233,010
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,023	78,023
利益剰余金	467,920	419,966
自己株式	△9,588	△9,507
株主資本合計	591,315	543,443
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,214	4,810
繰延ヘッジ損益	△14	213
為替換算調整勘定	△2,483	7,653
その他の包括利益累計額合計	1,716	12,677
新株予約権	1,374	1,572
少数株主持分	10,720	10,587
純資産合計	605,127	568,279
負債純資産合計	775,527	801,290

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)
売上高	358,511	392,900
売上原価	244,622	262,520
売上総利益	113,889	130,380
販売費及び一般管理費		
研究開発費	54,859	57,394
その他	53,692	65,741
販売費及び一般管理費合計	108,552	123,135
営業利益	5,336	7,244
営業外収益		
受取利息	1,022	1,009
受取配当金	245	1,791
補助金収入	1,263	1,117
その他	1,415	851
営業外収益合計	3,947	4,770
営業外費用		
為替差損	227	2,619
その他	251	304
営業外費用合計	478	2,923
経常利益	8,805	9,091
特別利益		
固定資産売却益	930	88
その他	—	18
特別利益合計	930	107
特別損失		
減損損失	6	46,583
関係会社整理損	133	—
組織再編費用	132	—
その他	113	158
特別損失合計	386	46,741
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失(△)	9,349	△37,542
法人税等	7,916	△2,032
過年度法人税等	2,194	—
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△760	△35,510
少数株主利益	175	111
四半期純損失(△)	△936	△35,621

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純損失 (△)	△760	△35,510
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△643	608
繰延ヘッジ損益	△34	197
為替換算調整勘定	4,539	8,768
その他の包括利益合計	3,860	9,573
四半期包括利益	3,099	△25,936
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,888	△26,116
少数株主に係る四半期包括利益	211	180

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結損益計算書関係)

減損損失

当第3四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)

当社グループは、事業用資産について、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位ごとに資産のグルーピングを行っております。再編等の決定された拠点については、個別案件ごとにグルーピングを行っております。

当第3四半期連結累計期間において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

① 連結子会社 TEL Solar Holding AG に関するのれん及び固定資産の減損損失

場所	用途	種類	減損損失 (百万円)
Trubbach, St. Gallen, Switzerland	工場	のれん、機械装置等	32,635

PV製造装置事業における連結子会社 TEL Solar Holding AG 取得時に計上したのれんについて、経営環境の著しい悪化により売上が当初の計画を下回って推移している状況を踏まえ、減損テストを実施した結果、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を特別損失に計上しております。回収可能価額については、使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込まれないことから、零として評価しております。

また、同社及びその連結子会社における機械装置等については、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を特別損失に計上しております。回収可能価額は正味売却価額により測定しておりますが、転用や売却が困難であることから、正味売却価額を零として評価しております。

② 連結子会社 TEL NEXX, Inc. に関するのれん等の減損損失

場所	用途	種類	減損損失 (百万円)
Billerica, Massachusetts, U. S. A.	工場	のれん等	5,009

半導体製造装置事業における連結子会社 TEL NEXX, Inc. 取得時に計上したのれん等について、売上が当初の計画を下回って推移している状況を踏まえ、減損テストを実施した結果、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を特別損失に計上しております。なお、回収可能価額については、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを14.0%で割り引いて算定しております。

③ 拠点再編計画に伴う固定資産の減損損失

場所	用途	種類	減損損失 (百万円)
茨城県つくば市 (テクノロジーセンターつくば)	研究所	建物及び構築物、機械装置等	4,403
宮城県仙台市 (テクノロジーセンター仙台)	研究所	建物及び構築物、土地等	3,345
その他	—	建物及び構築物等	316

上記資産グループについては、再編等の決定により今後の使用見込がたたないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を特別損失に計上しております。

なお、回収可能価額については、正味売却価額により測定しており、土地、建物及び構築物については第三者により合理的に算出された市場価格等に基づいて算定し、その他の機械装置等については、転用や売却が困難であることから、正味売却価額を零として評価しております。

④ その他

上記の他、873百万円を減損損失として特別損失に計上しております。

(セグメント情報等)

① 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」、「FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置」、「PV(太陽光パネル)製造装置」及び「電子部品・情報通信機器」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、プラズマエッチング/アッシング装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「PV製造装置」は、薄膜シリコン太陽光パネル用製造装置の開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「電子部品・情報通信機器」は、集積回路(IC)を中心とした半導体製品、その他電子部品、コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア等の設計・開発・仕入・販売等を行っております。

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第3四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD 製造装置	PV 製造装置	電子部品・ 情報通信機器				
売上高	297,086	18,206	4,485	73,556	8,891	402,226	△9,325	392,900
セグメント利益 又は損失(△)	37,950	294	△42,005	201	1,051	△2,508	△35,033	△37,542

- (注) 1. 「その他」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流、施設管理及び保険業務等であります。
2. セグメント利益又は損失の調整額△35,033百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△14,741百万円及び、拠点再編により遊休となる建物及び構築物等に係る減損損失等△8,938百万円であります。
3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純損失と調整を行っております。

③ 報告セグメントの変更等に関する事項

TEL Solar Holding AG を連結子会社としたことに伴い、第1四半期連結会計期間より、報告セグメントを従来の「F PD/PV製造装置」から「F PD製造装置」及び「PV製造装置」に変更しております。

④ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

当第3四半期連結累計期間における、セグメントごとの減損損失計上額は、以下のとおりであります。詳細は「(四半期連結損益計算書関係)」を参照ください。

(単位：百万円)

	報告セグメント				その他	合計	調整額 (注)	四半期連結損益 計算書計上額
	半導体 製造装置	F PD 製造装置	P V 製造装置	電子部品・ 情報通信機器				
減損損失	5,009	—	32,635	—	—	37,644	8,938	46,583

(注) 調整額の金額は、主として、拠点再編により遊休となる建物及び構築物等に係るものであります。

(のれんの金額の重要な変動)

当第3四半期連結会計期間において減損損失を計上したこと等により、「半導体製造装置」セグメントののれんが前連結会計年度末に比べ4,976百万円減少しております。「PV製造装置」セグメントについては、前連結会計年度に暫定処理を行っておりましたTEL Solar Holding AGの取得原価の配分が当第3四半期連結会計期間において確定したことにより、のれんが増加しましたが、その全額を減損損失として計上したことにより、前連結会計年度末に比べ23,396百万円減少しております。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。